

<<电工与SMT电子工艺实训>>

图书基本信息

书名：<<电工与SMT电子工艺实训>>

13位ISBN编号：9787560962528

10位ISBN编号：7560962521

出版时间：2010-8

出版时间：华中科技大学出版社

作者：曹海泉，李威 主编

页数：110

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电工与SMT电子工艺实训>>

内容概要

本书是作者从高等院校加强实习、实训等实践教学环节的实际需求出发，结合多年在电工与SMT电子工艺实践教学方面的经验和体会，以及与同类高校深入交流的成果，为满足高等教育理工类培养应用型本科专业人才的要求而编写的。

全书介绍电工与SMT电子工艺实践的主要环节，从焊接技术、印制电路设计、元器件测试及安装、电子产品的组装和调试，以及表面贴装技术等方面，对电子工艺的流程进行讲解。

表面贴装技术是一种直接将元器件平卧在印制电路板上进行焊接安装的新技术，是当今电子组装的主流技术。

采用表面贴装技术，能使电子产品轻薄短小、降低成本、提高可靠性。

另外，对计算机辅助设计软件Protel 99 SE也作了简单介绍，让学生在掌握基础的电子工艺技术的同时，也了解最新的和先进的电子工艺知识。

本书可作为高等院校弱电类专业本科、专科学生的电工与SMT电子工艺实践教学的指导书，还可作为从事电工与SMT电子工艺制作的科技人员的参考书。

<<电工与SMT电子工艺实训>>

书籍目录

第1章 手工锡焊技术 1.1 锡焊的机理 1.2 锡焊工艺的种类 1.3 手工锡焊的工具 1.4 锡焊的材料 1.5 锡焊的条件及焊前准备 1.6 手工锡焊技术 1.7 拆焊技术 1.8 元器件的安装与焊接 思考与习题第2章 印制电路板设计 2.1 相关概念 2.2 印制电路板及其工艺的分类 2.3 印制电路板的设计原则 2.4 习作设计 思考与习题第3章 常用电子元器件的识别与测试 3.1 电阻器 3.2 电容器 3.3 电感器、变压器 3.4 半导体分立器件 3.5 集成电路 3.6 其他常用元器件检测 3.7 实习产品1：S-2000型直流稳压/充电电源 3.8 实习产品2：声光控延时节电开关 思考与习题第4章 Protel 99 SE计算机辅助设计 4.1 Protel 99 SE的操作环境 4.2 绘制电路原理图 4.3 印制电路板的设计 思考与习题第5章 SMT概论 5.1 SMT的基础知识 5.2 SMT的历史和现状 思考与习题第6章 表面贴装的刷锡技术 6.1 印刷机的基础知识 6.2 基板的基础知识 6.3 焊膏的基础知识 思考与习题第7章 表面贴装的贴装技术与焊接技术 7.1 贴片机的基础知识 7.2 表面贴装芯片的基础知识 7.3 回流焊机的基础知识 思考与习题第8章 SMT实训：迷你型FM收音机的组装 8.1 SMT实训的目的 8.2 SMT实训的产品特点 8.3 电路原理 8.4 SMT实训流程 思考与习题附录A FM收音机的电路原理附录B FM收音机的元件安装位置图附录C 常见故障、原因及修正参考文献

<<电工与SMT电子工艺实训>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>